

2025 年 11 月吉日

DEIM2026 産学連携委員会

委員長 北島信哉（富士通）

副委員長 松村優也（LayerX）

DEIM2026 へのご支援のお願い（スポンサー募集）

DEIM2026 のスポンサー企業・団体の募集をご案内いたします。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM）は、データ工学と情報マネジメントに関する様々な研究テーマの討論・意見交換を目的としたワークショップです。2022 年までの数年間は新型コロナウイルスによる感染拡大の可能性を考慮し、完全オンライン形式で開催しておりましたが、DEIM2023 以降、with コロナ時代の新たな試みとして「直列ハイブリッド形式」で開催し、オフラインで熱い議論が交わされてきました。

DEIM2026 においても一般発表（1 日目～3 日目）をオンラインで、その後オフライン会場に集まり、4 日目と 5 日目はチュートリアルやポスター発表を中心として議論を交わします。運営一同、ポストコロナ時代の学術会議のあるべき姿を模索しながら準備を進めてまいります。

<DEIM2026 開催概要>

【名称】

第 18 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM2026）
（第 24 回日本データベース学会年次大会）

【主催】

日本データベース学会
電子情報通信学会 データ工学研究専門委員会
情報処理学会 データベースとデータサイエンス研究会

【Web ページ】

<https://pub.conf.it.atlas.jp/ja/event/deim2026>

【開催期日】

2026 年 2 月 28 日（土）～3 月 5 日（木）
※ 3 月 3 日（火）は休み（移動日）

【開催形態】

直列ハイブリッド形式
2 月 28 日～3 月 2 日：オンライン開催
3 月 4 日、5 日：オンサイト開催

【オンサイト会場】

神戸国際会議場・展示場（ポートアイランド）

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-9-1

<https://kobe-cc.jp/ja/facilities/exhibition-hall/>

DEIM2026 の協賛プランは、「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」の 3 つのプランを用意しております。また、日本データベース学会（DBSJ）の活動を常日頃からご支援いただいている DBSJ 維持会員各位には、協賛金の割引をいたします。特典の内容については、下記をご覧ください。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、お申し込み多数の場合には、一部の特典をご提供できない可能性がございます（先着順とさせていただきます）。上限数はプログラム編成や会場の制約等に応じて変動する可能性がございます。あらかじめご了承くださいますと幸いです。お早めのお申し込みをお願い申し上げます。特典の詳細は、お申し込み後に改めてご案内いたします。

スポンサー申し込みの締め切りは特にございませんが、2026 年 1 月 7 日（水）を過ぎますと技術報告やインタラクティブ発表の枠が取れない可能性が高いため、それまでの申し込みを推奨しております。また、ランチョンセミナーを希望される場合は、遅くとも 12 月 12 日（金）までに、少なくとも関心がある旨を産学連携担当までご連絡ください。

協賛の実施について、ご検討くださいますよう、なにとぞお願い申し上げます。

1. 協賛プラン

	協賛特典	プラチナ 44 万円 (税込) ※1	ゴールド 22 万円 (税込) ※1	シルバー 5.5 万円 (税込) ※1
1	ロゴ掲載（Web ページ・バーチャル背景）	大	中	小
2	現地での常設ブース等の設置 ※2	大ブース	小ブース	---
3	技術報告への登壇 ※3	1 枠	1 枠	---
4	インタラクティブ発表 ※3	1 枠	1 枠	---
5	スポンサー賞の授与 ※4	○	---	---
6	現地ランチョンセミナー開催権（限定 3 枠） ※5	○	---	---
7	ノベルティスペースでのノベルティ配布	---	---	○
8	大会無料参加 ※6	5 名	3 名	1 名

※1 DBSJ 維持会員には、協賛金の割引（20%）をご提供いたします。是非この機会にご入会をご検討ください（DBSJ 維持会員について <https://dbsj.org/overview/sponsor/>）。

- ※2 会場都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。また、ブースのサイズはプラチナスポンサー様のほうが大きいものとなります。
- ※3 プログラム編成の都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。
- ※4 受賞者へ贈呈する副賞は別途ご準備いただく必要がございます。
- ※5 開催権の行使には追加費用を別途申し受けます。この追加費用には弁当手配費用が含まれる予定で、手配は DEIM 実行委員会にて実施いたします。金額は現在関連業者と調整中です。興味がある場合、産学連携委員会までお問合せください。
- ※6 無料参加枠を超えての参加は、通常通りの参加費のお支払いをお願いいたします。

1.1. 募集要項

ご協賛いただくスポンサー様は、DBSJ／DEIM で対象とするデータ工学および情報マネジメントに関わる技術をサービスや製品の開発にご活用されている、もしくはこれら分野の研究に取り組まれていることを原則といたします。

1.2. 協賛プランのポイント

DEIM2026 では、昨年度に引き続きより多くの露出機会を持っていただくことに注力いたします。また、例年好評をいただいている「技術報告への登壇」はオンラインでの開催とし、より多くの参加者に聴講されるようにいたします。DEIM2026 では、新たに現地会場における「インタラクティブ発表」と「ノベルティスペースでのノベルティ配布」を特典としてご用意いたします。

多くの露出機会

すべてのプランで「ロゴの掲載（Web ページ・バーチャル背景）」、ゴールドプラン以上で「技術報告への登壇」「インタラクティブ発表」「現地での常設ブースの設置」、プラチナプランで「スポンサー賞の授与」「ランチョンセミナーの開催権」、シルバープランで「ノベルティスペースでのノベルティ配布」をご利用可能となります。参加者への露出機会の増加に是非ご活用ください。

テクノロジーショーケースとしての技術報告

技術報告は、各社の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピールなど、各社のテクノロジーショーケースとしてご好評いただいております。

スポンサー賞授与を通じた学生による優れた研究活動の奨励

DEIM2025 でもご好評いただいたスポンサー賞を、引き続き設定いたします。スポンサー様のそれぞれの視点で選考していただくスポンサー賞は、学生の研究活動に大きな励みとなることが期待されます。是非、スポンサー様それぞれのオリジナリティあふれる副賞とともに、学生による優れた研究活動をご奨励ください。スポンサー賞はプラチナプランでご利用可能です。

スポンサー企業・団体間でのノウハウやプラクティスの共有

産学連携の強化のため、スポンサー賞など新しい試みに挑戦しております。ハイブリッド形式、オンライン形式の学会参加、協賛に不慣れなスポンサー様や、新たに DEIM への協賛をご検討くださっているスポンサー様にも協賛特典を有効活用していただくべく、スポンサー間でノウハウやプラクティスを共有する場を、DEIM2025 に引き続き設けます。スポンサー間のつながりやコミュニティ作りの一助となれば幸いです。

1.3. スポンサー費用のお支払い期日

スポンサー費用のお支払い期日は、2026 年 2 月 27 日(金)とさせていただきます。

2. 特典について

2.1. ロゴ掲載

DEIM2026 の Web ページと、オンラインミーティング用のバーチャル背景画像にロゴを掲載します。

DEIM2026 の Web ページには、ご希望のリンク先へのリンクを張ったロゴを掲載します。ロゴの大きさは協賛プランによって異なります。ロゴ掲載順は同じ協賛プランの種別ごとにお申し込み順を予定しています。

(ご参考) DEIM2025 のロゴ掲載：<https://pub.conf.it.atlas.jp/ja/event/deim2025>

バーチャル背景画像は、実行委員等がオンラインミーティング時にバーチャル背景として利用します。バーチャル背景へのロゴ掲載順は、同じ協賛プランの種別毎にお申し込み順を予定しています。

(ご参考) DEIM 2025 で配布した背景画像

https://pub-files.atlas.jp/public/deim2025/image/deim202520250218131114082BJL_ja_20250218131114084.jpg

ロゴのご提出方法については、お申し込み後にご連絡いたします。

2.2. 常設ブースの設置（現地会場）

DEIM2026 の現地会場に、常設ブースを設置いたします。本特典は「プラチナ」「ゴールド」プランのみに提供します。

常設ブースは現地会場で行われるポスター発表の会場に設置されます。設置期間は、オフライン期間 2 日間のうち 1 日目の午後いっぱい と 2 日目の午前いっぱいの約 1 日を予定しております。この 1 日のうち、大半の時間帯では同じ会場でポスター発表が実施されている予定ですので、多くの学会参加者がブースにも足を運ぶと期待できます。

「プラチナ」プランのスポンサー様には 180cm の長机とポスターを 2 枚掲示可能なパネルのご提供を予定しています。「ゴールド」プランのスポンサー様には、90cm の長机とポスターを 1 枚掲示可能なパネルのご提供を予定しています（「プラチナ」プランのおおよそ半分のブースサイズとなります）。また、「プラチナ」プランのブースの方が「ゴールド」プランのブースよりも相対的に目立つ場所への設置を予定しております。

可能な限り多くのスポンサー様にブースを設置いただけるよう検討してまいりますが、ブース設置のお申し込み多数の場合は上位スポンサー様優先および先着順とし、上限に達した場合にはお申し込みを打ち切る場合がございます。スポンサー数や会場の制約等によって、スペース提供の形態に若干の変更が生じる可能性もございますことをご承知おきください。

ブースのイメージ画像は下記となります。

ゴールド

<https://app.box.com/s/1ektt1w4c5wtejd8qt7j7nlr4rmanb3x>

プラチナ

<https://app.box.com/s/vk8q1mdysatx4snwuayrga97pimc4mg6>

現地会場に設置するブースのサイズ・設営方法については、後日ご連絡いたします。

2.3. 技術報告への登壇（オンライン）

DEIM2026 のオンラインでの口頭研究発表セッション内でスポンサー様の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピール等を実施いただける技術報告への登壇の権利を「プラチナ」「ゴールド」プランに提供します。

技術報告でご発表いただく内容は、スポンサー様独自の技術的なコンテンツに限ります。学術会議である DEIM2026 のセッション内でご発表いただくという観点からのご配慮願います。

昨年度の各社発表内容（タイトル）は、昨年度のプログラムからご参照ください。

<https://pub.conf.it.atlas.jp/ja/event/deim2025/search?f=%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%A0%B1%E5%91%8A&t=presentation>

（ページ内で「技術報告」で検索しています）

発表時間は、DEIM2026 の論文発表に準じます。ご発表の題目とご発表者のお名前を、論文発表と同様にプログラムに掲載します。ご発表のセッションは、ご希望をお伺いした上で検討しますが、ご希望に添えない場合もございますことをご承知おきください。

なお、技術報告にご登壇いただく方にも、DEIM2026 への参加登録を別途お願いしております。技術報告でのご発表だけでなく、セッションへの参加や参加者との交流を通して、

DEIM2026 を盛り上げていただければ幸いです。

2.4. インタラクティブ発表（現地会場）

ポスター発表会場にて一般の発表者と同様にポスター発表をしていただけます。本特典は「プラチナ」「ゴールド」プランに提供します。

掲載するポスターは技術報告と同様に、スポンサー様独自の技術的なコンテンツに限ります。一般の発表者と並んでポスター発表ができますので、スポンサーブースに足を運ばれない方に対するアピールが期待できます。

2.5. スポンサー賞の授与

スポンサー様独自のご見識に基づいて、学生の研究活動を奨励していただくことを目的とした、スポンサー賞の授与権を提供します。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供します。

スポンサー賞の選定対象は、DEIM2026 で発表された学生を筆頭著者とする研究発表です。スポンサー様ごとに、授与の候補となる発表をいくつか選定していただきます。最終的な授与対象は、多くの学生の発表を奨励する観点から、産学連携委員とスポンサー賞の授与を希望するスポンサー様とを含むメンバーで協議の上で決定いたします。選定の方法や協議の方法については DEIM2026 開催までにご連絡いたします。

また、副賞の授与をしていただくことも可能です。副賞は各スポンサー様でご用意ください。なお、受賞者間の公平性という観点から、**市価 10 万円（税別）を超えるような高価な副賞はご遠慮いただくようお願いいたします。**

ご参考までに、過去に受賞した学生から喜ばれた副賞の事例を以下に示します。

- **今後の研究に活用できるもの**

ディープラーニングの研究をしている学生などを念頭に、GPGPU カードなどを贈呈

- **研究室の全員で楽しんでもいただけるデバイス**

研究室の飲み会や旅行などで活用していただけるデバイス（360° カメラなど）を贈呈

- **強いメッセージ性のある副賞**

「研究を頑張ってほしい」という意味を込めて、「エナジードリンク 1 年分」などの賞品を贈呈

- **入手の心理的ハードルが高いデバイス**

Kickstarter でしか買えない VR 系デバイスやドローンなどを贈呈

- **特別な機会の提供**

賞品ではなく、オフィス見学へのご招待やキーパーソンの方とのお食事など、学生が普段なかなか得られない機会を副賞として提供

2.6. ランチョンセミナーの開催権（現地会場）

スポンサー独自のランチョンセミナーを開催する権利を先着3社・団体様にご提供します。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供し、追加の費用を申し受けます。この追加費用はセミナーで提供する昼食（お弁当）の費用を含みます。費用は昼食業者と調整中です。昨年度実績は10万円（税込）であり、本年も大きくはずれない見込みです。興味のある企業様は産学連携委員までお問い合わせください。

ランチョンセミナーでは、スポンサー様独自のイベントや講演を開催していただくことができます。技術報告とは異なり、技術的なコンテンツに限定をいたしません。開催する時間帯は、学会4日目（オフライン1日目）のお昼を予定しております。詳細な開催の時間帯や開催方式については後日ご連絡させていただきます。

ランチョンセミナーを希望される場合、遅くとも12月12日（金）までに、少なくとも関心がある旨を産学連携委員までお申し出ください。

2.7. ノベルティスペースでのノベルティ配布（現地会場）

ノベルティスペースでのノベルティ配布を行う権利を提供します。本特典は「シルバー」プランにのみ提供します。

ノベルティスペースはポスター会場内のコーヒー・茶菓コーナーの周辺を予定しております。企業・組織名やロゴの入ったノベルティやパンフレットなどを会場宛にご送付いただき、運営側でノベルティスペースに陳列いたしますので、ご都合が悪く現地会場に来られないスポンサー様でもお申し込みが可能です。ご希望される場合には陳列後の様子を写真撮影し、メールにて送付させていただきますので、産学連携委員までご連絡をお願いいたします。

ご送付いただくノベルティは段ボール3箱までとさせていただきます。また、飲食物のご送付はご遠慮ください。余ったノベルティのご返送はいたしかねますので、ご了承ください。

スペースに限りがございますので先着順とさせていただきます、上限に達した場合にはお申し込みを打ち切る場合がございます。

3. お申し込み方法

お申し込みは、下記 google フォーム「DEIM2026 協賛申し込みフォーム」からお願いいたします。お申し込み受付は2025年12月1日（月）9:00 JST 開始とします。

<https://forms.gle/uWk7UwsCqyWaNk2w8>

google フォームでの申し込みが難しい場合、「DEIM2026 協賛申し込みフォーム」と同様の内容をご記入の上、下記連絡先までメールでお申し込みください。

連絡先：< deim2026-sponsor-inquiry@googlegroups.com >

※受付開始時刻よりも早いお申し込みは受け付けられません。再度の送信をお願いいたします

※お申し込みを確認次第、担当者からメールをお送りします。そちらを持って、お申し込み完了とさせていただきます。

協賛金のお支払い方法については、後日、ご担当者様にご連絡いたします。

4. 問合せ先

ご不明点やご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

連絡先：< deim2026-sponsor-inquiry@googlegroups.com >

なお、DEIM2026 のスポンサー様を含む、企業間の交流（ノウハウやプラクティスの共有）を目的とした Slack を試験的に開設しております。お申し込みいただいたスポンサー様、あるいはお申し込みを検討しておられる企業のご担当者様または関係者様は以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

https://join.slack.com/t/db-inter-company-com/shared_invite/zt-2t0i456s5-5zgZjyirND5o050HEKf7Hg

以上